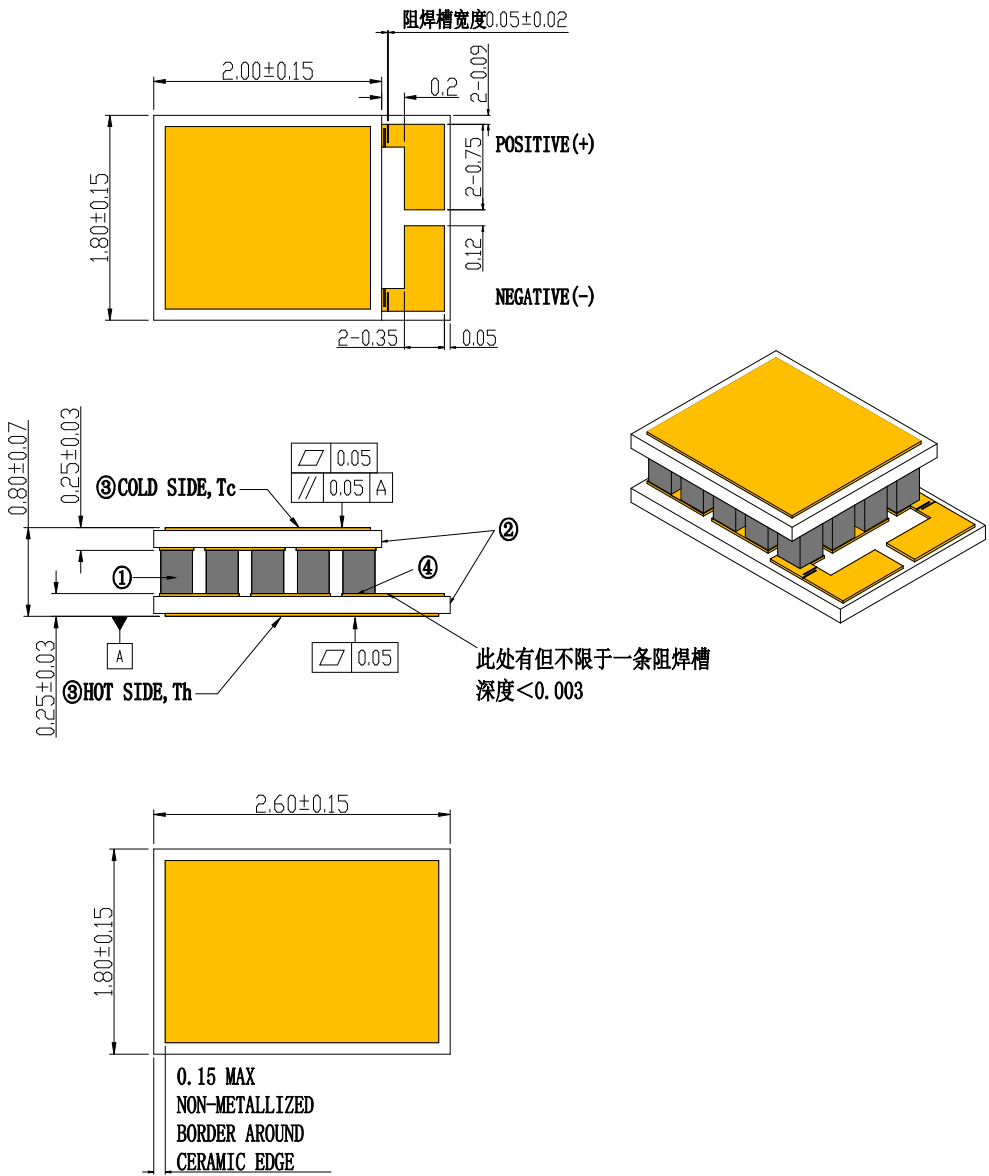




升版记录			
版 本	更 改 内 容	修 订 者	日 期
A1	初版发行		2020/03/01
A2	ACR范围修订		2020/05/18
A3	连接Pad位铜条图形变更		2020/10/17
A4	误写金锡焊料含量比例, 修订为“Au78Sn22”		2020/12/10
A5	在Pad位处增加阻焊槽及其宽度、深度标注		2022/01/21

Material	
①	晶粒对数: 10对 PN pellets:10 pairs
②	冷热面陶瓷基板材料: ALN(导热系数: 170~200W/m*K) Hot and Cold Side Substrates: Ceramic
③	表面金属化层材料组成: Cu/Ni/Pd/Au; 厚度: 20um/4.5±1.5um/0.075um/0.1um
④	焊料层材料组成: Au78Sn22; 最高允许工艺温度265℃, 2min Soldering 265 Celsius

Th=27℃				Th=85℃				Ta=27℃
ΔTmax/℃	Qc max/W	Umax/V	Imax/A	ΔTmax/℃	Qc max/W	Umax/V	Imax/A	ACR/Ω
70.92	0.87	1.15	1.21	93.97	1.10	1.50	1.18	0.74~0.90

RoHS		REACH		未注公差: ±0.05mm		HUA HAI		产品名称	热电制冷器件 (TEC)
设计		会签		物料编码		比 例		产品型号	TEM1-010012A-NM-3B
审核		标准化				10:1		产品图号	TZ-5001-A5
工艺		批准		共 1 页		第 1 页		客户编码	